

Gudeng Precision Industrial Co. Ltd

家登精密工業股份有限公司



2023.12

Partner with **H.E.A.R.T.** , Grow with **P.A.S.S.I.ON.**

發言人：沈恩年 營運長
電話：(02)2268-9141
郵件：AmyShen@gudeng.com



免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述，是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知不確定性的影響，實際結果將可能於表述內容不同，以上所提供之所有資訊僅供參考，實際資料請參考公開資訊觀測站。

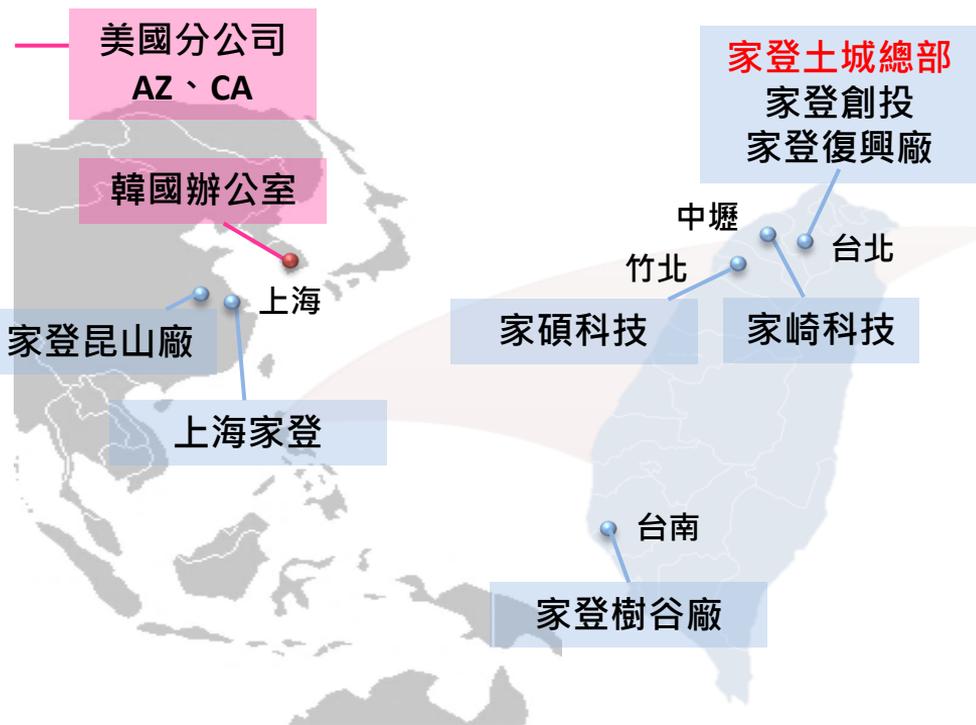
另除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。



家登-先進載具設備領航者



家登精密



- 成立於：1998年3月20日
- 員工數：900 人
- 實收資本額：NT 883,844,030
- 集團2020營業額：NT 25 億元
- 集團2021營業額：NT 31.2 億元
- 集團2022營業額：NT 44.9 億元
- 集團2023 1~10月營業額：NT 42.76 億元
(與去年同期成長25%)

■ 主力產品：

半導體事業

- ① 光罩傳載解決方案
- ② 晶圓傳載解決方案
- ③ 半導體機台設備
- ④ 其他服務

航太事業

- ① 動力液壓阻尼油缸
- ② 液壓傳輸高壓導管
- ③ 動態平衡馬達基座
- ④ 正負壓熱傳導隔片



半導體產業供應鏈

PC/NB

通訊

消費性電子

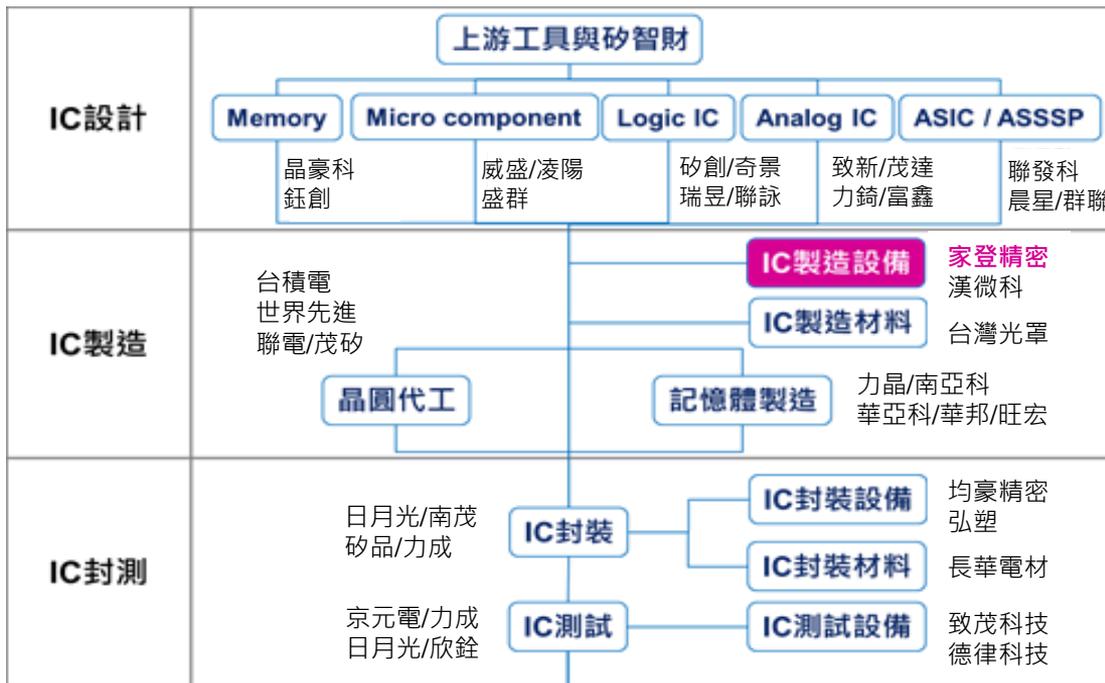
汽車電子

工業

國防



需求



家登精密



2024年全球半導體產業概況

世界半導體貿易統計(WSTS)展望2024年，全球半導體市場預計可望成長11.8%，達到5,760億美元。

- 以美國市場為首將成長 **17.7%**，亞太市場將成長 **10.7%**，歐洲及日本市場將分別成長 **7.7%** 及 **7.8%**。
- 記憶體市場可望激增 **43.2%**，是驅動整體半導體市場回升的主要動力。感測器市場可望揚升 **5.7%**。

Spring 2023	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Americas	141,136	128,236	150,989	16.2	-9.1	17.7
Europe	53,853	57,253	61,637	12.8	6.3	7.7
Japan	48,158	48,724	52,534	10.2	1.2	7.8
Asia Pacific	330,937	280,881	310,838	-3.5	-15.1	10.7
Total World - \$M	574,084	515,095	575,997	3.3	-10.3	11.8
Discrete Semiconductors	33,993	35,904	38,192	12.0	5.6	6.4
Optoelectronics	43,908	45,949	45,881	1.2	4.6	-0.1
Sensors	21,782	20,410	21,575	13.7	-6.3	5.7
Integrated Circuits	474,402	412,832	470,349	2.5	-13.0	13.9
Analog	88,983	83,907	88,902	20.1	-5.7	6.0
Micro	79,073	71,470	75,855	-1.4	-9.6	6.1
Logic	176,578	173,413	185,266	14.0	-1.8	6.8
Memory	129,767	84,041	120,326	-15.6	-35.2	43.2
Total Products - \$M	574,084	515,095	575,997	3.3	-10.3	11.8

(來源：WSTS@ tsia.org.tw)



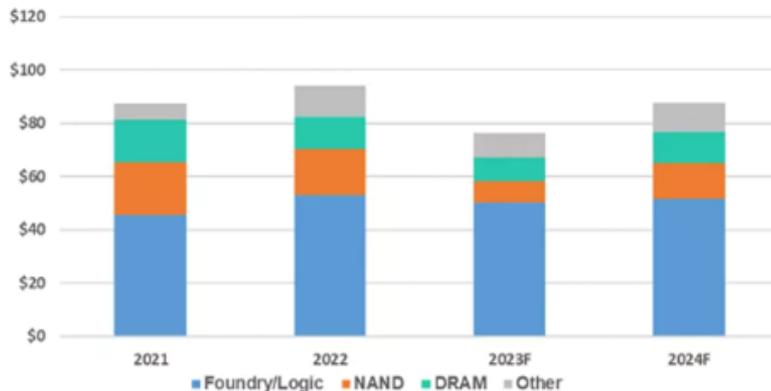
2024年全球晶圓廠設備支出預估

晶圓廠設備銷售額2023年將下降18.8%至764億美元，預計直至2024年，晶圓廠設備領域將佔復甦的大部分，達到 1000 億美元，銷售額達到 878 億美元，**成長 14.8%**。**測試設備**市場銷售額於2023年萎縮15%至64億美元，**組裝/封裝設備**於2023年下降20.5%至46億美元；而SEMI預測此2大領域設備將於2024年分別**成長 7.9%** 和 **16.4%**。

- 反應出終端市場需求疲軟，**代工和邏輯應用設備**在先進製程保持穩定成長，但針對成熟製程其銷售額於2023年同比下降 6%至501億美元。2024 年代工和邏輯投資將**成長 3%**。
- 而消費者和企業對內存和存儲的需求持續疲軟，預計2023年**DRAM設備**銷售額將下降28%至88億美元，但2024 年將**回升 31%**至116 億美元。
- NAND 設備**銷售額預計將下降51%至84 億美元，到 2024 年將**激增 59%** 至 133 億美元。

(來源：SEMI 2023 年 7 月)

SEMI 2023 Mid-Year Wafer Fab Equipment Forecast by Application (US\$ Billion)

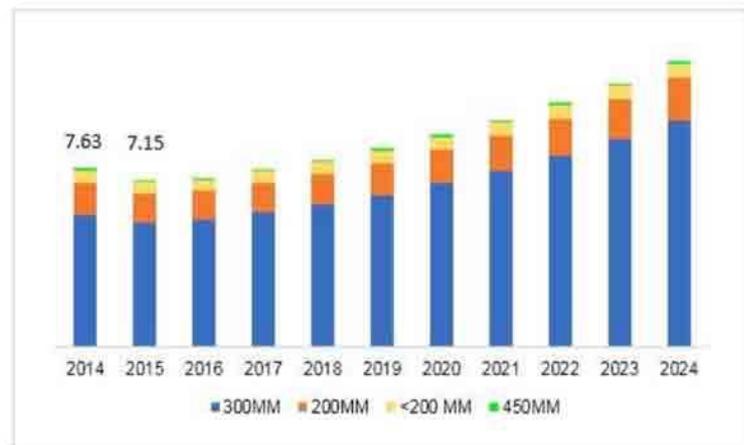




2024年全球矽晶圓出貨趨勢

半導體市況不佳，原本被矽晶圓廠視為中長期業績保證的長約面臨鬆動，產業供過於求的情況，恐延至2025年。展望2024年，矽晶圓製造的關鍵成長因素為300mm晶圓將被更廣泛應用，而業界也積極探索碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)等晶圓替代材料，為功率半導體應用中提供卓越的性能。

- **日本信越**新型GaN on QST晶圓，配合客戶未來大尺寸晶圓的GaN製程趨勢，建立12吋QST晶圓的生產技術，期望能挹注新營收。
- **SUMCO**上季由於客戶端持續進行生產調整，導致邏輯IC、記憶體用的12吋矽晶圓出貨量都減少，矽晶圓需求預估將在2023年後半觸底，2024年後將隨著數據中心、車用、5G智慧機等市場擴大，成長率預估將逐步復甦。
- **環球晶**以2023年看下半年客戶依舊有庫存壓力，但大部分客戶Q3開始庫存消化慢慢去化，Q4可望回穩，2024年營運比2023年更有發展。

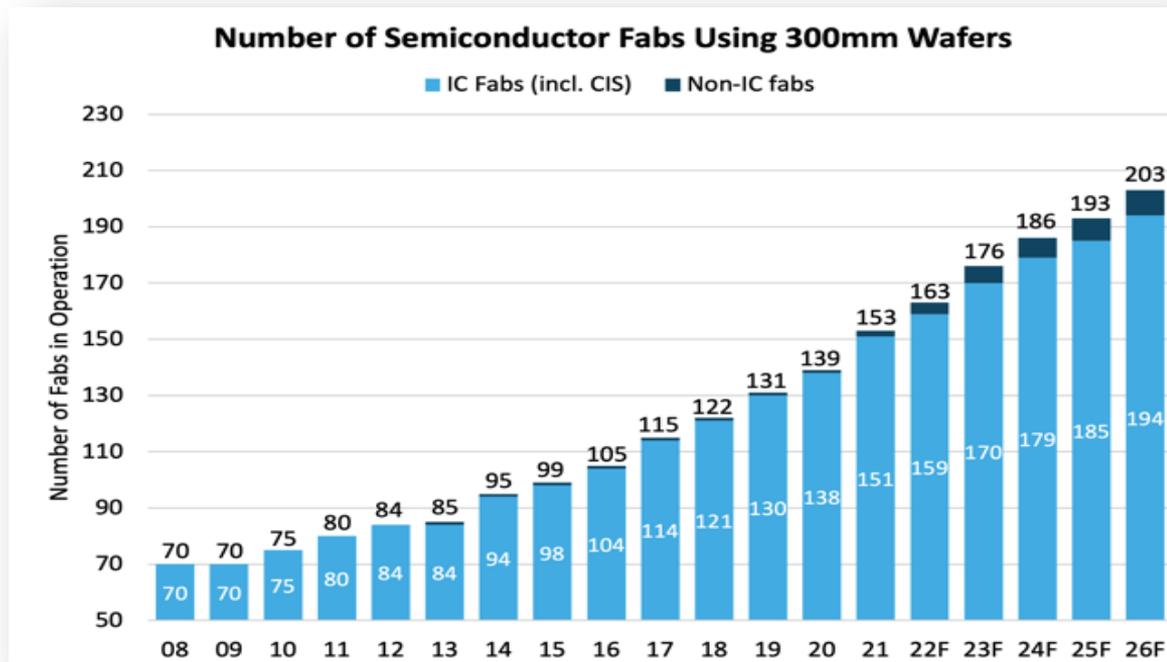


(來源：Semiconductor Overview / 工商時報 / 經濟日報 / 財訊快報 / 財經新報)



2024年全球晶圓廠新建廠預估

從數據顯示，至2024年將擁有**186座300毫米晶圓廠**，每月晶圓廠產能將成長約180萬片晶圓，達到700萬片以上。



(來源：SEMI)



光罩載具解決方案

晶圓載具解決方案

自動化系統解決方案



產品應用

	設計	前段製程	OSAT/ 後段製程
	IC Design / Mask maker	Foundry/ IDM	Assembly/ Wafer sorting/ Final Test
光罩載具	V	V	V
晶圓載具		V	V
自動化系統	V	V	



半導體製程

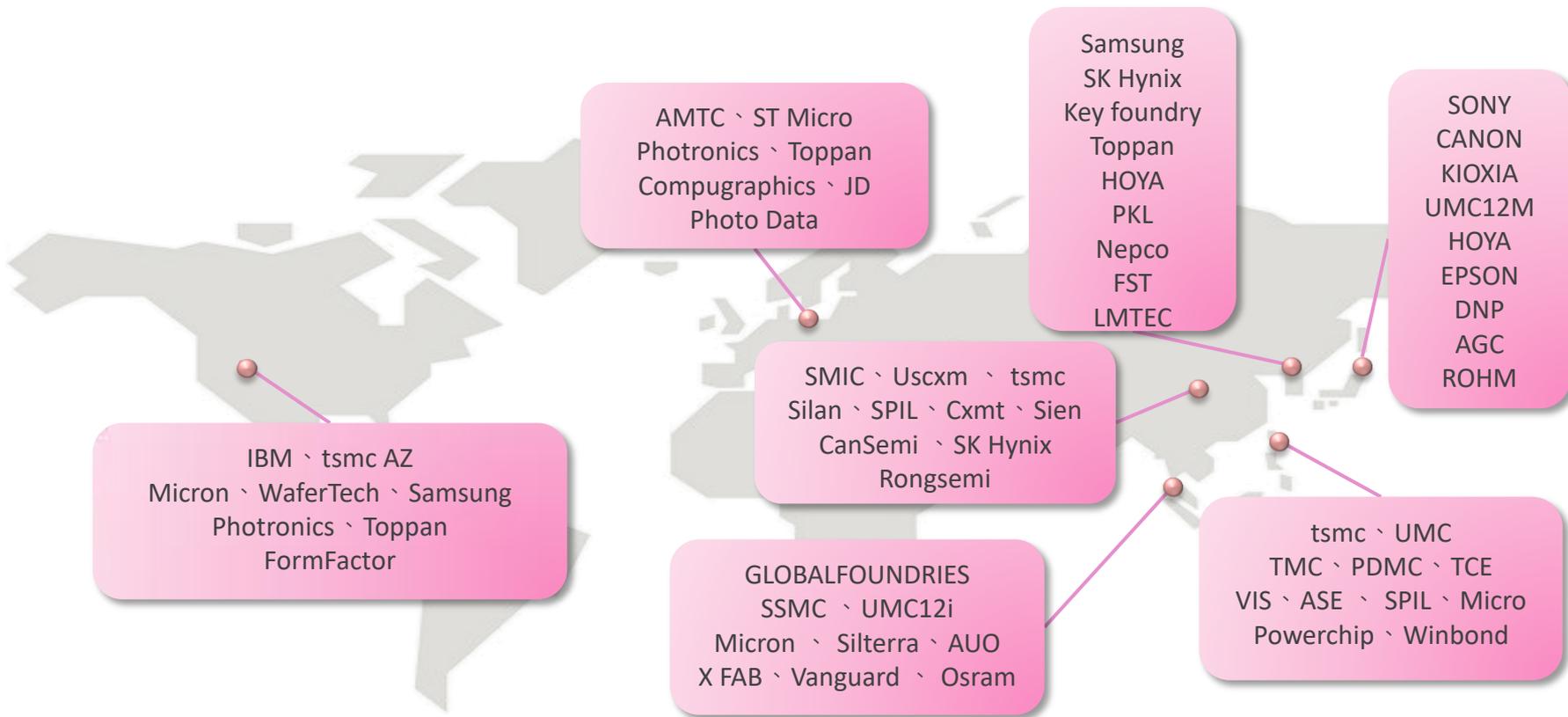




半導體客戶分布

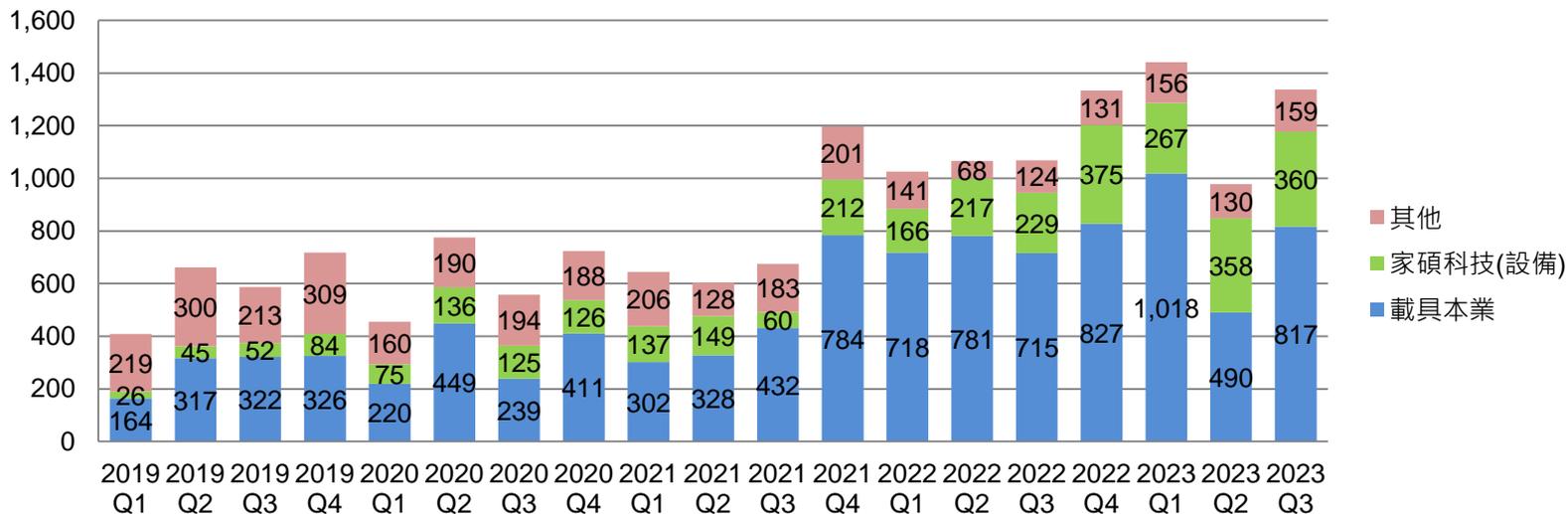


家登精密



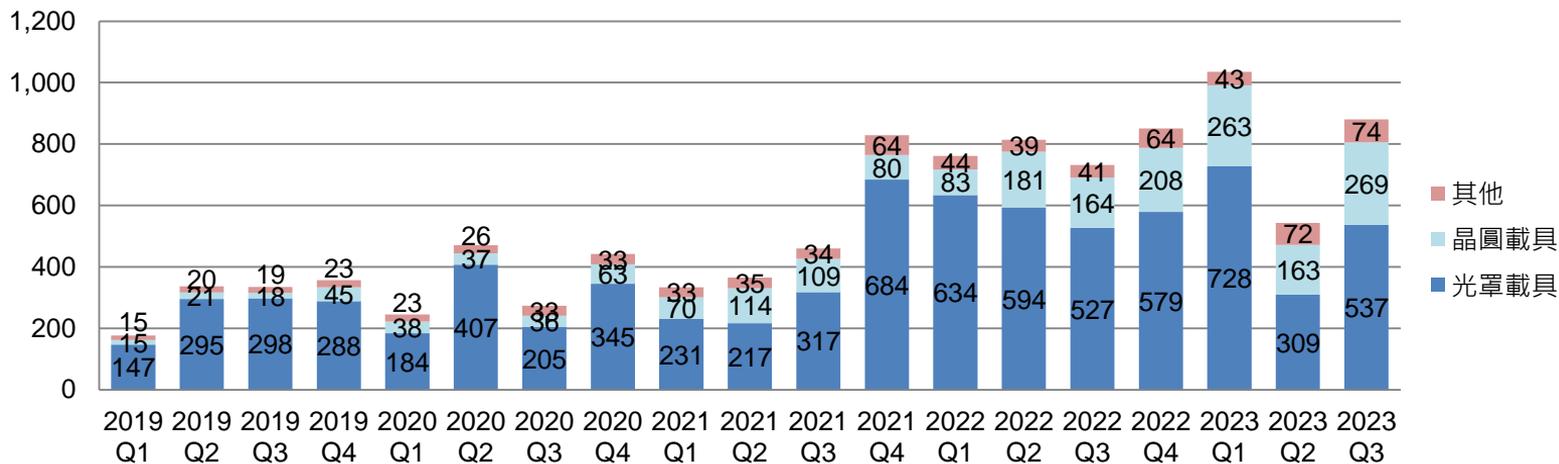


Consolidated Revenue



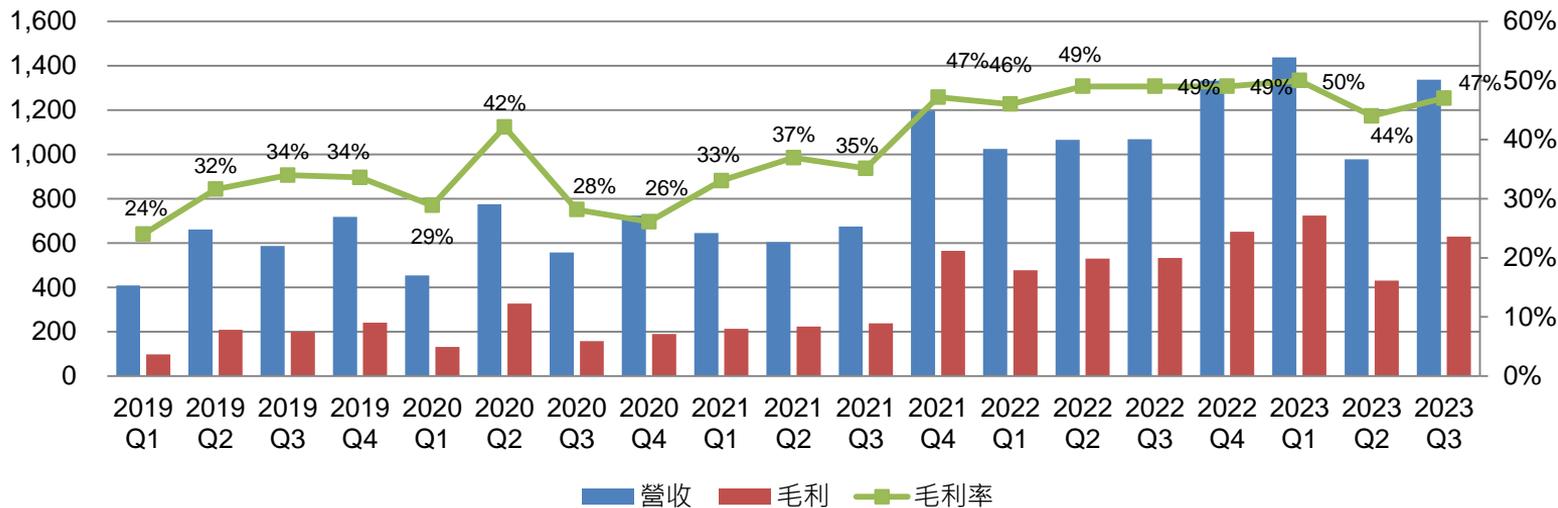


Core Business Revenue





家登每季營收毛利





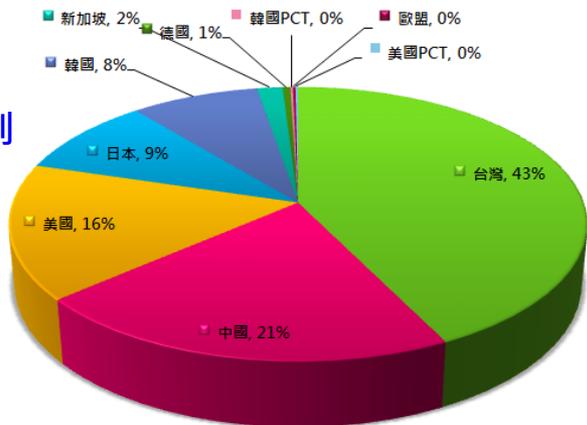
家登專利、研發、設備資本支出



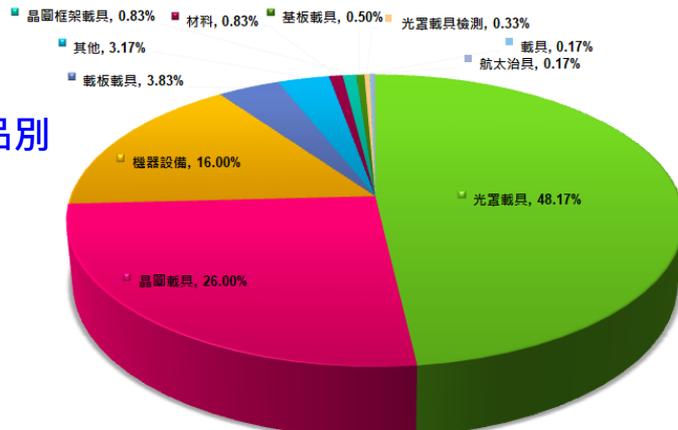
	2019	營收%	2020	營收%	2021	營收%	2022	營收%	2023 (至10月)	營收%
研發經費	84,190	6.94%	120,553	8.43%	146,422	7.34%	222,723	7.05%	230,465	7.98%
設備 資本支出	157,252	12.96%	594,625	41.58%	441,913	22.15%	758,999	24.02%	343,095	11.88%

仟元

專利地區別



專利產品別



截至2023年10月止，獲得國內外**610**項專利的肯定，持續建構高技術含量之專利版圖



家登發展藍圖



家登精密

半導體載具領航者



Hi-NA EUV關鍵載具
成熟晶圓載具
先進晶圓載具
先進3D封裝載具



醫療方案輔助者



泌尿科治療輔具
血管支撐解決方案
結石吸引治療機



「深耕關鍵客戶」
「開拓新客戶」
「發展新市場」
三大策略重點聚焦發展

「**協同創新Co-Creation**」
整合上中下游客戶、供應商
尋找優質併購標的
擴展集團事業體

航太產業先驅者

動力液壓阻尼油缸
動態平衡馬達基座
液壓傳輸高壓導管
正負壓熱傳導隔片



新技術研發

載具清洗機
載具儲存方案
精密檢測解決方案
精密加工解決方案





家登ESG實踐績效



榮獲天下永續公民獎
榮獲天下人才發展獎
榮獲TCSA台灣企業永續獎 企業永續報告 白金級



經濟面



2022集團營收
44.9億元

2022 每股盈餘
11.12元

RBA行為準則
200分白金級認證

獲得人力資源領域最高榮譽
國家人才發展獎



社會面

連續三年調薪率**7-9%**，
優於同業標準



員工自主推動社區參與公益達**382**人次

獎助學金達**651**人



與12間大學院校進行產學合作達**55**位，
累計學習時數**55,840**小時

環境面

廠區節電**78.6**萬度



節水**52,436**噸m³

以大帶小，**攜手10家供應鏈**，提出能源改善方案，
成功減碳**1,160**噸二氧化碳當量、節電**228**萬度

次料循環利用專案，回收**再製棧板、運輸箱、人體工學椅**





家登整體轉型績效



營收：自2019年突破20億元新台幣大關後，2022年達45億元，2023年1~10月42.76 億，較去年同期成長25%

毛利率：2018年突破20%，2022年49%，2023前三季平均47%

年度每股淨利 (EPS)：2018年為0.27元，2019年3.25元，2022年11.12元，2023前三季7.96元

市占率：光罩盒全球市占超過70%、EUV光罩盒超過85%、FOUP晶圓盒陸續通過大客戶認證，大中華半數以上客戶採用家登為baseline



家登集團展望與策略



- 大中華市場：

- ◆ 家登昆山廠即將投產，預計明年1月起貢獻產能，目標大中華市場自給自足
- ◆ 中國FOSB耕耘開始發酵，陸續驗證成功多家客戶，明年搶攻市場
- ◆ 家登地緣政治優勢，在多家客戶廠區取得市占領先

- 美國市場：

- ◆ 聚焦先進製程，目標成為關鍵客戶main source
- ◆ EUV先進製程、3D封測(Panel FOUP)出貨穩定提升
- ◆ 配合大客戶美國布局，持續資源投入，目前在AZ備有倉儲及RD/FAE團隊，與台灣在地供應鏈聯盟聯手開拓新市場

- 台灣市場：

- ◆ 伴隨台灣大客戶全球擴廠，成為其全球主力供應商
- ◆ 先進製程晶圓載具通過驗證，明年可期
- ◆ 大客戶庫存調節告一段落，Q3全面恢復出貨，2024樂觀看待

- 航太事業：

- ◆ 關鍵零組件取得FAA認證許可正式出貨
- ◆ 通過多家大客戶認證並取得長單
- ◆ 航太策略性併購完善事業版圖，2024挑戰高營收目標



Thank You
www.gudeng.com